

COMPOSANT LOT DE DISQUES DE SILICIUM

FICHE N° 9963

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : LETI Laboratoire d'Électronique et de Technologie de l'Information - CEA-G

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle :

Matériaux : Silicium

Description

Il s'agit d'un ensemble de disques (dénommés "wafers") de silicium à différentes étapes de traitement. Ces disques permettent de produire plusieurs unités de puces sur un même support.

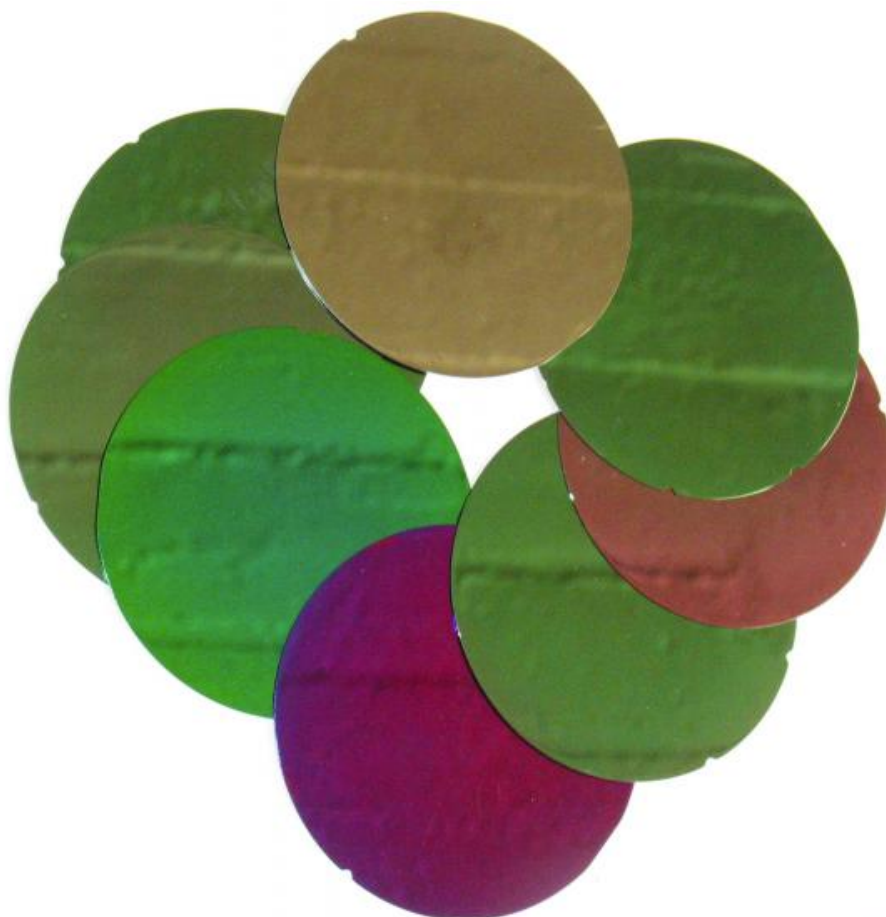
La taille de ces wafers a cru progressivement depuis les disques de 2,54 cm (1 pouce) à l'origine, jusqu'aux 12,5 cm (5 pouces) présentés ici. En 2016, la taille des wafers est couramment de 300 mm.

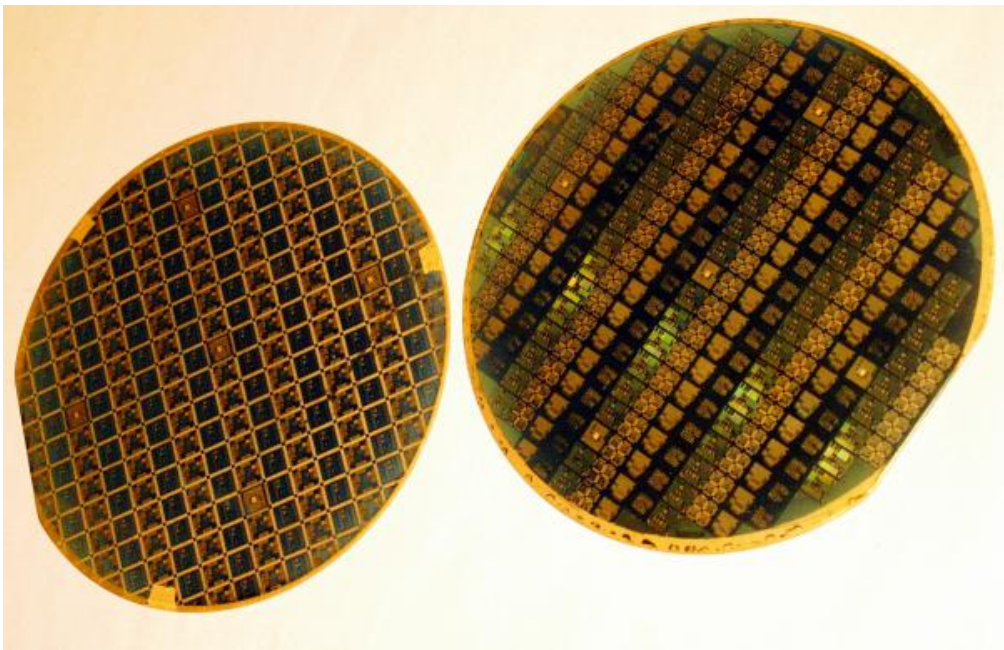
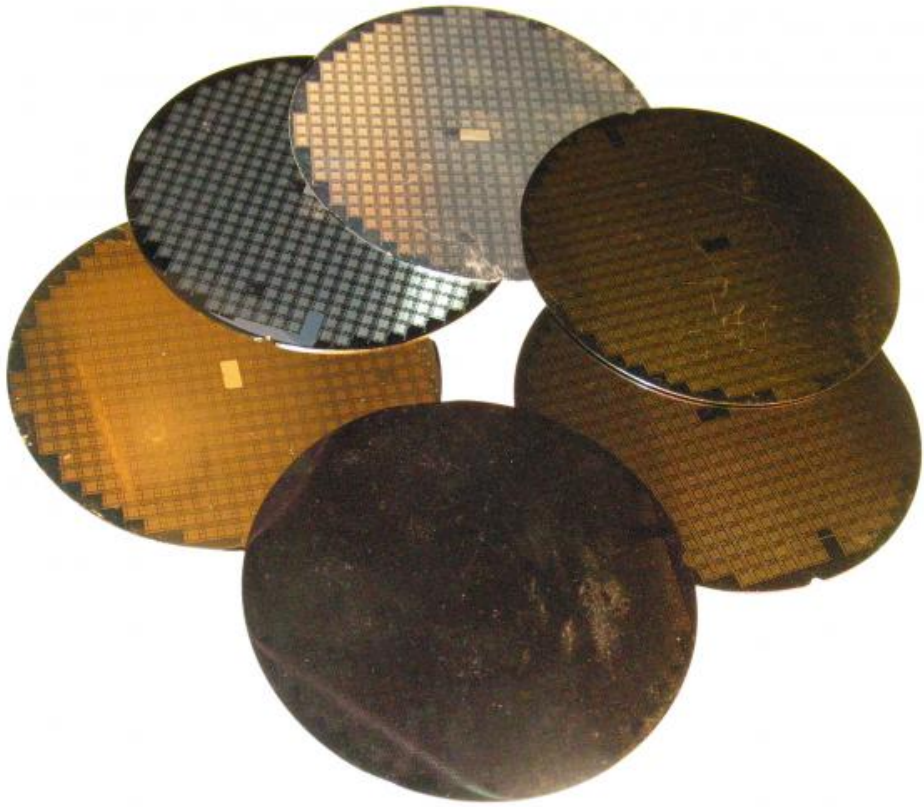
L'augmentation de taille des wafers était nécessaire d'une part pour pouvoir recevoir des circuits ("chips") de taille croissante, dépassant largement le cm², et d'autre part cela permet d'optimiser la production.

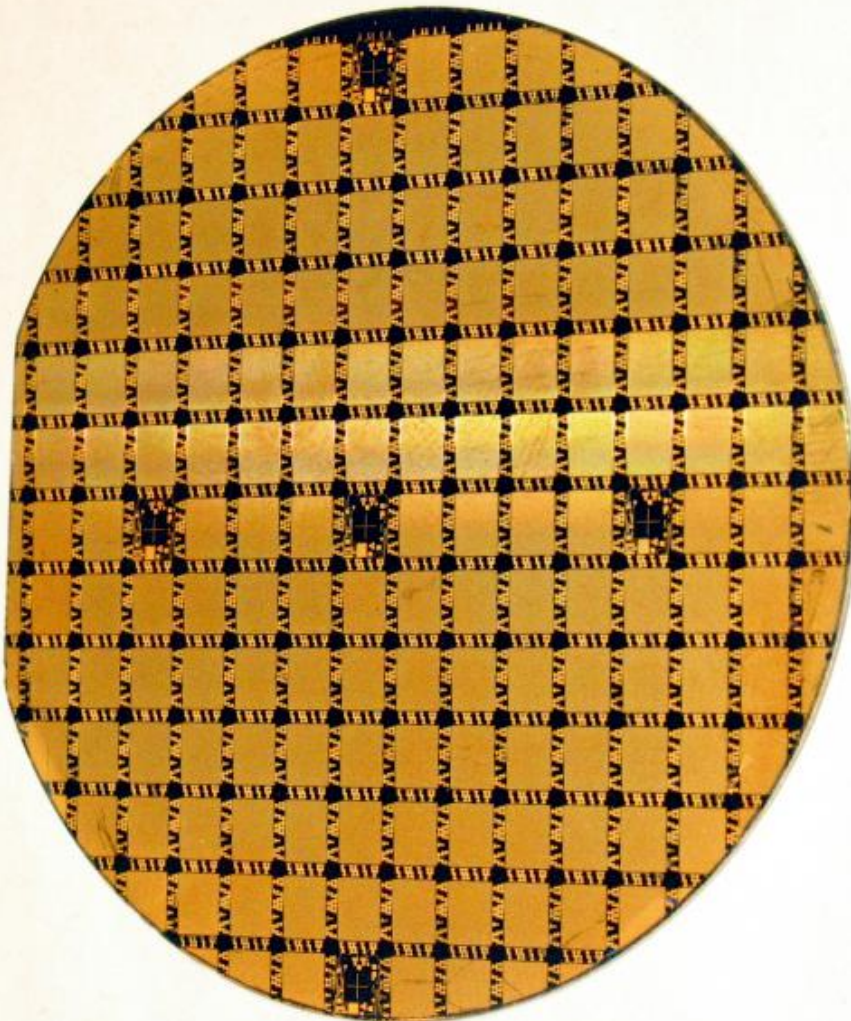
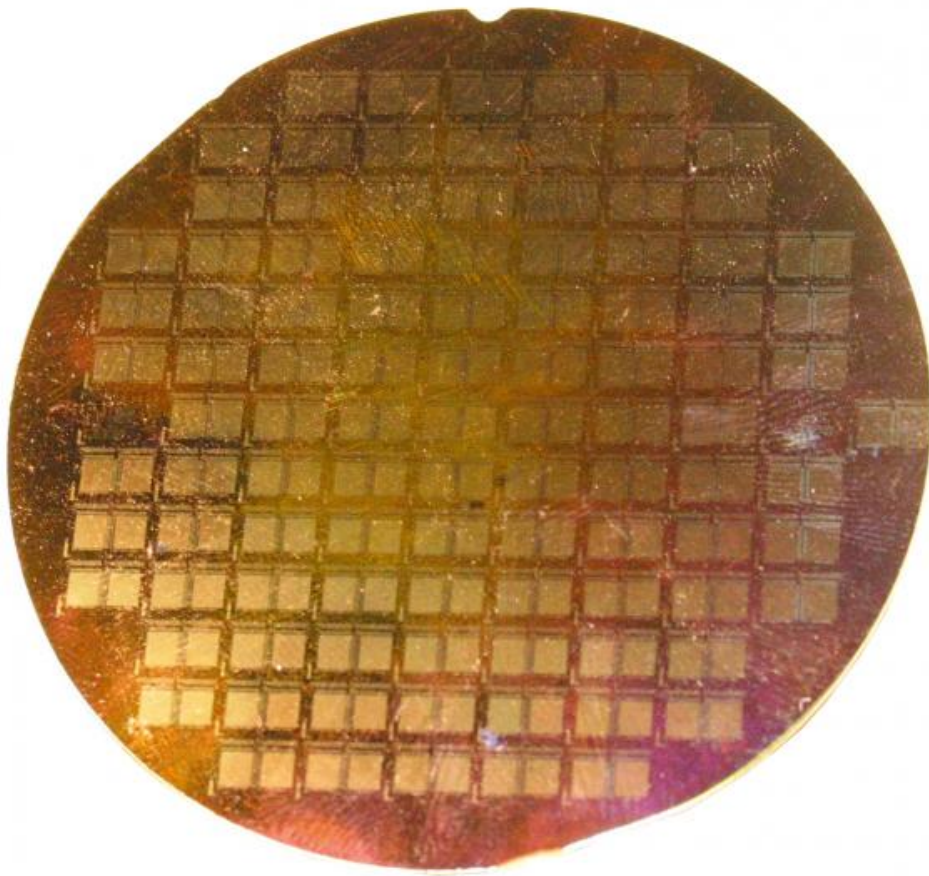
A l'issue des différents traitements, une machine découpe le wafer entre chaque circuit, afin de les isoler. Une pression sur une plaque faiblement bombée brise le wafer en autant de circuit à isoler.

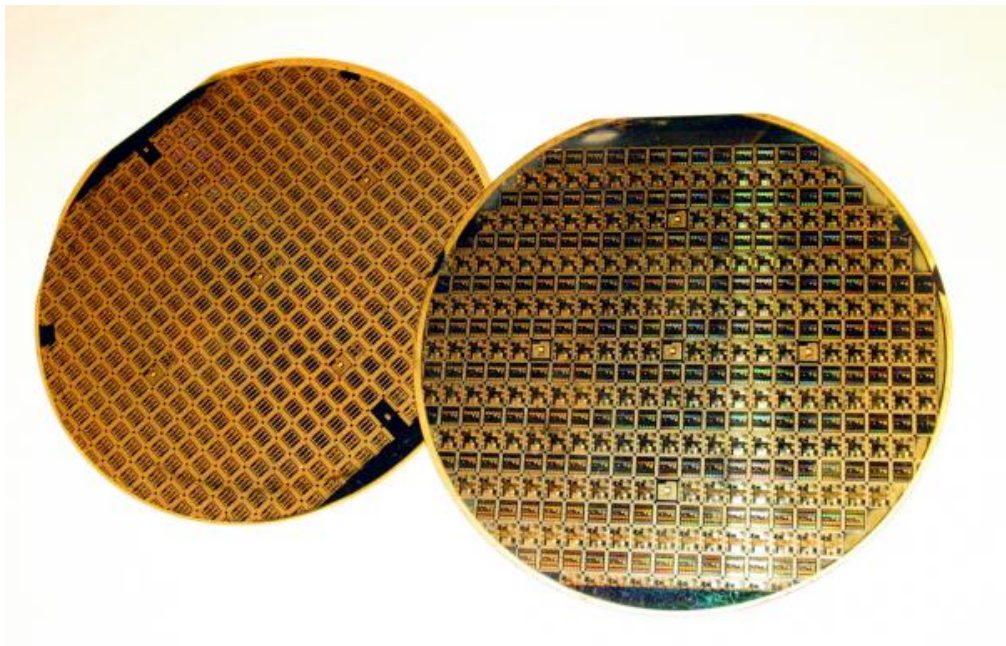
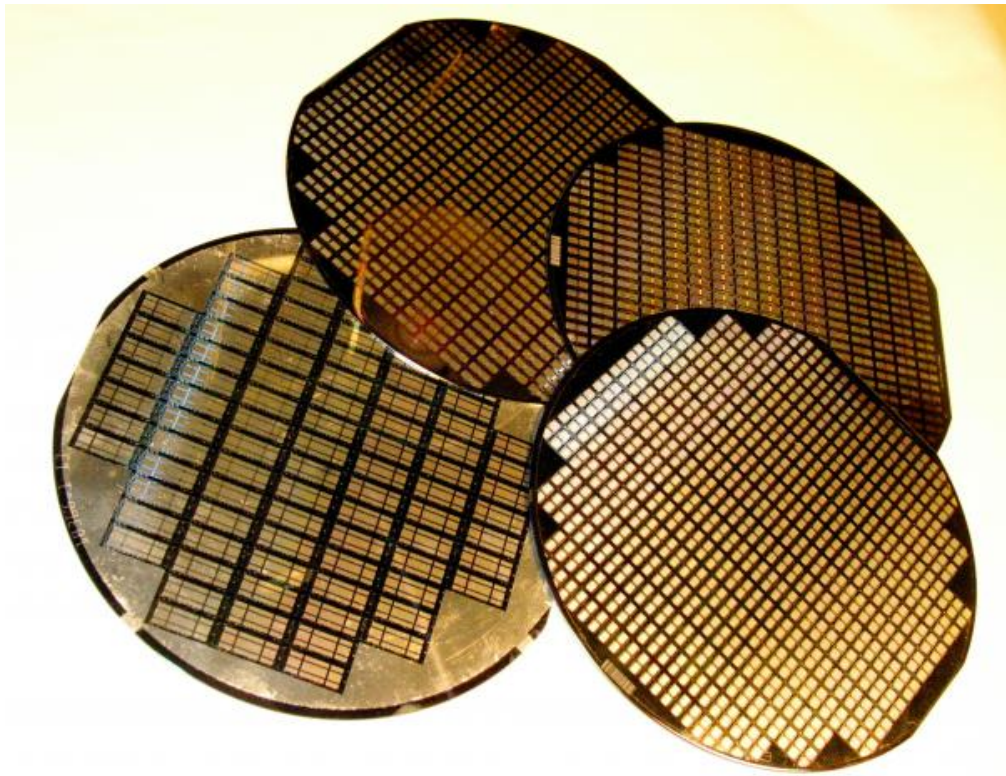
Utilisation

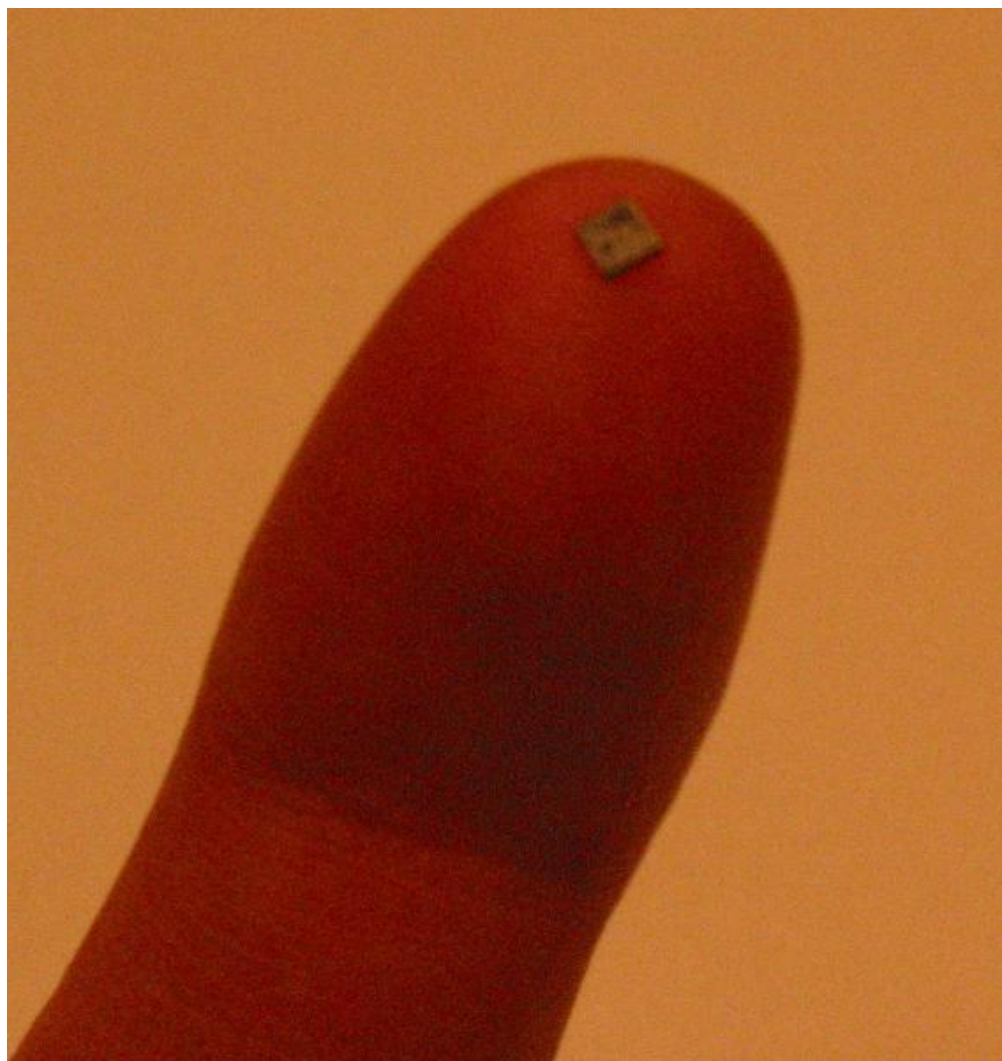
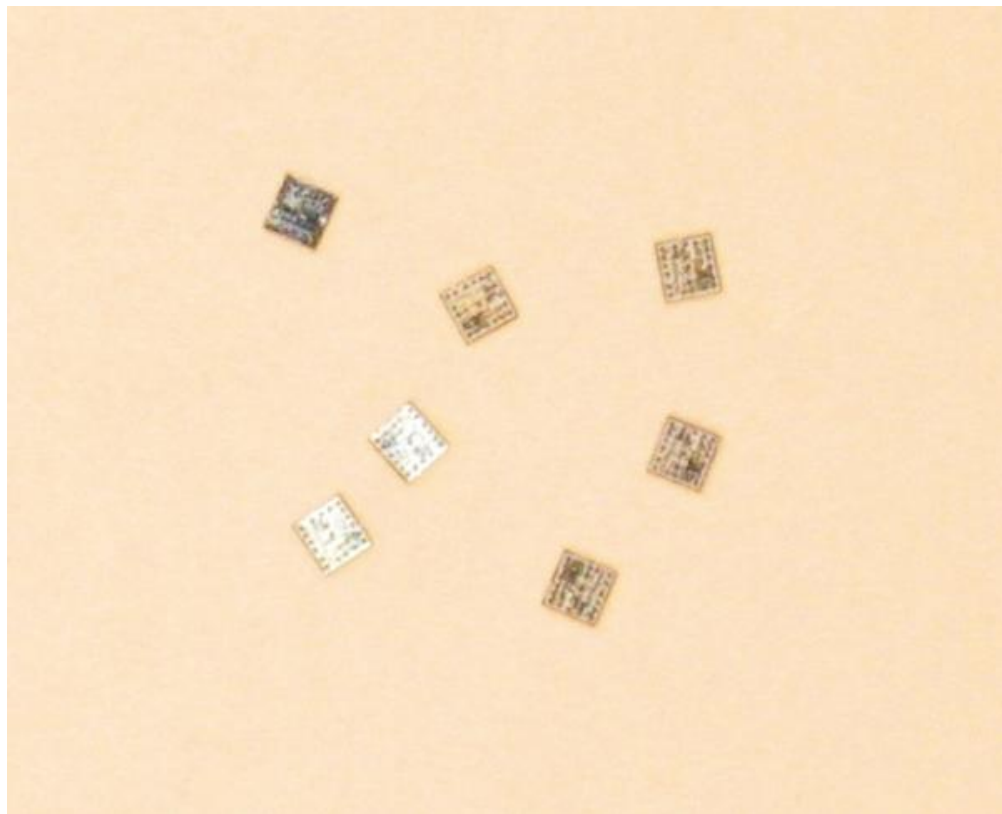
Ces circuits proviennent vraisemblablement du LETI, laboratoire grenoblois dépendant du CEA et pionnier dans le développement de nouvelles technologies de circuits intégrés. Le LETI a coopéré avec SGS Thomson, basé à St Égrève, devenu actuellement ST Microelectronics.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Composant Lot de disques de silicium (LETI Laboratoire d'Électronique et de Technologie de l'Information - CEA-G), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27684>, consulté le 2026-07-26

